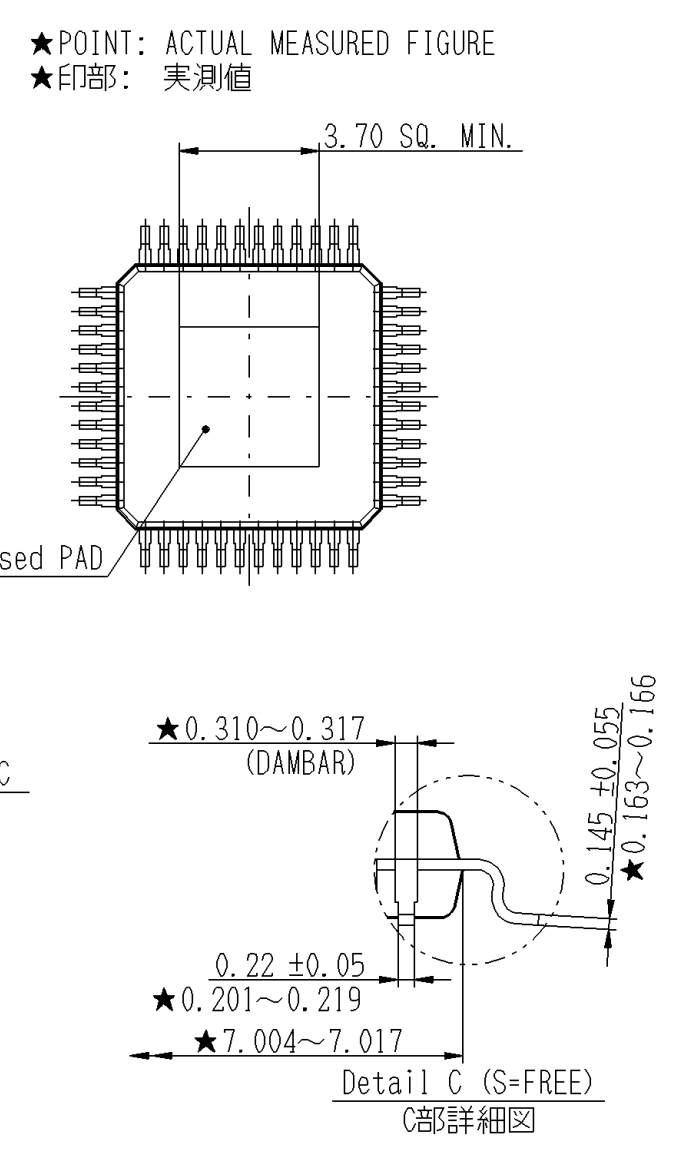
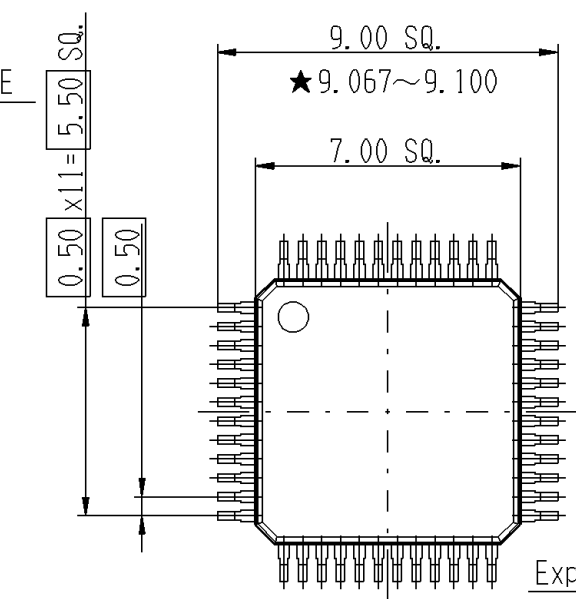
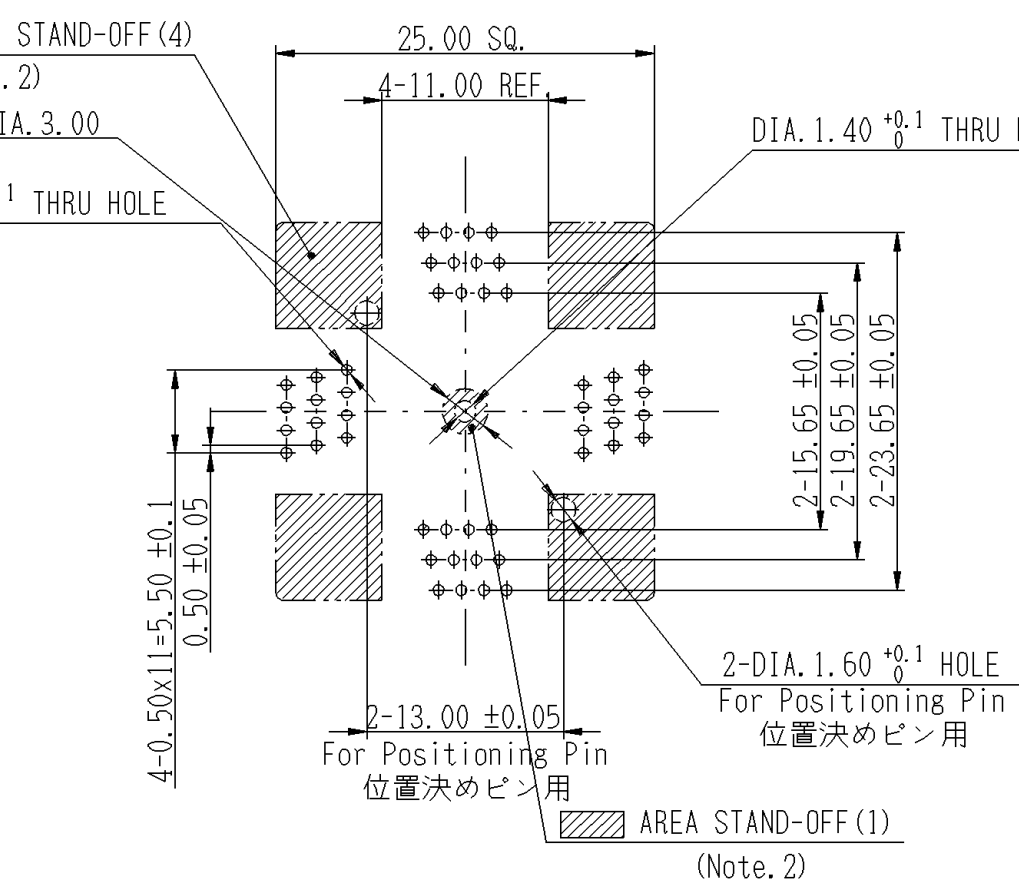
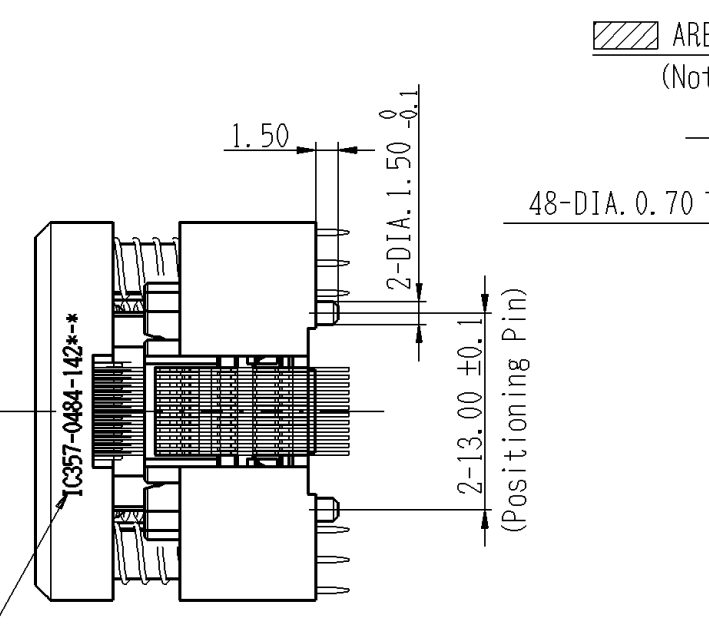
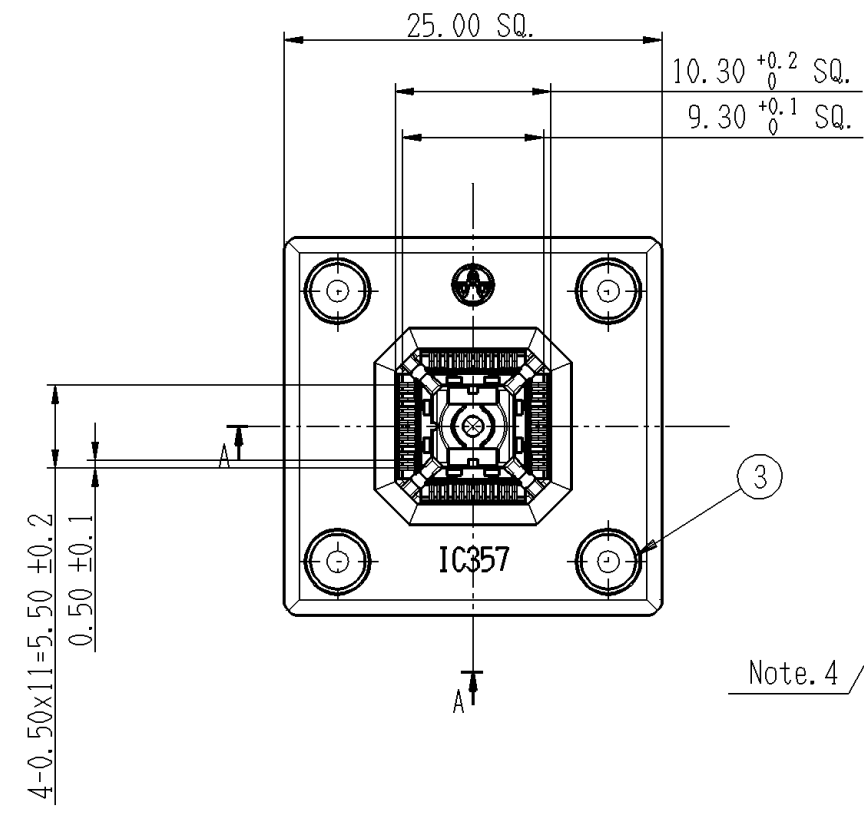
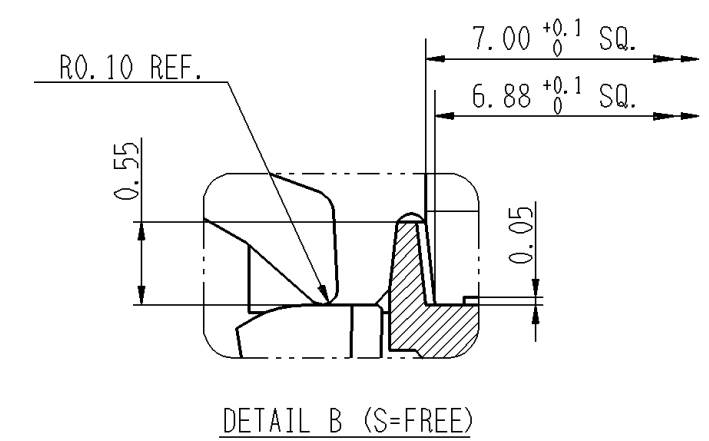


記号×数	変更内容	REVISION DESCRIPTION	承認	検図	担当	年・月・日	変更通知書番号
△×							
△×							
△×							
△×							
△×							



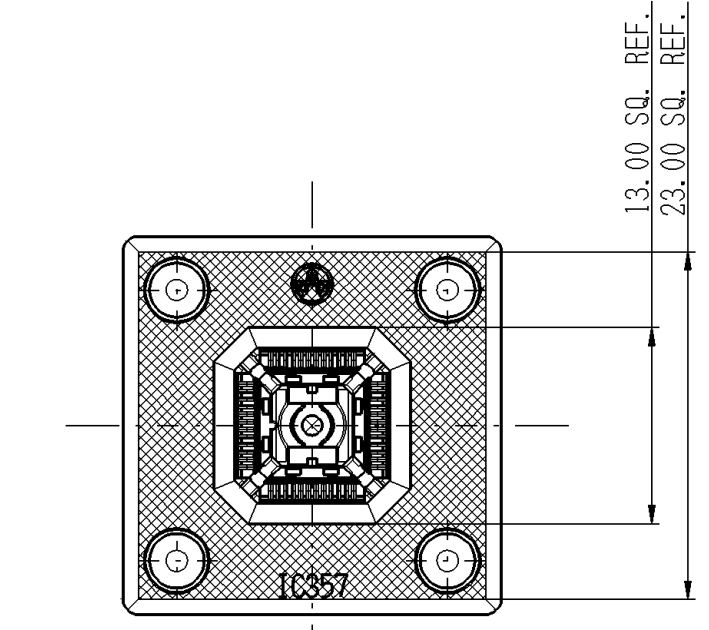
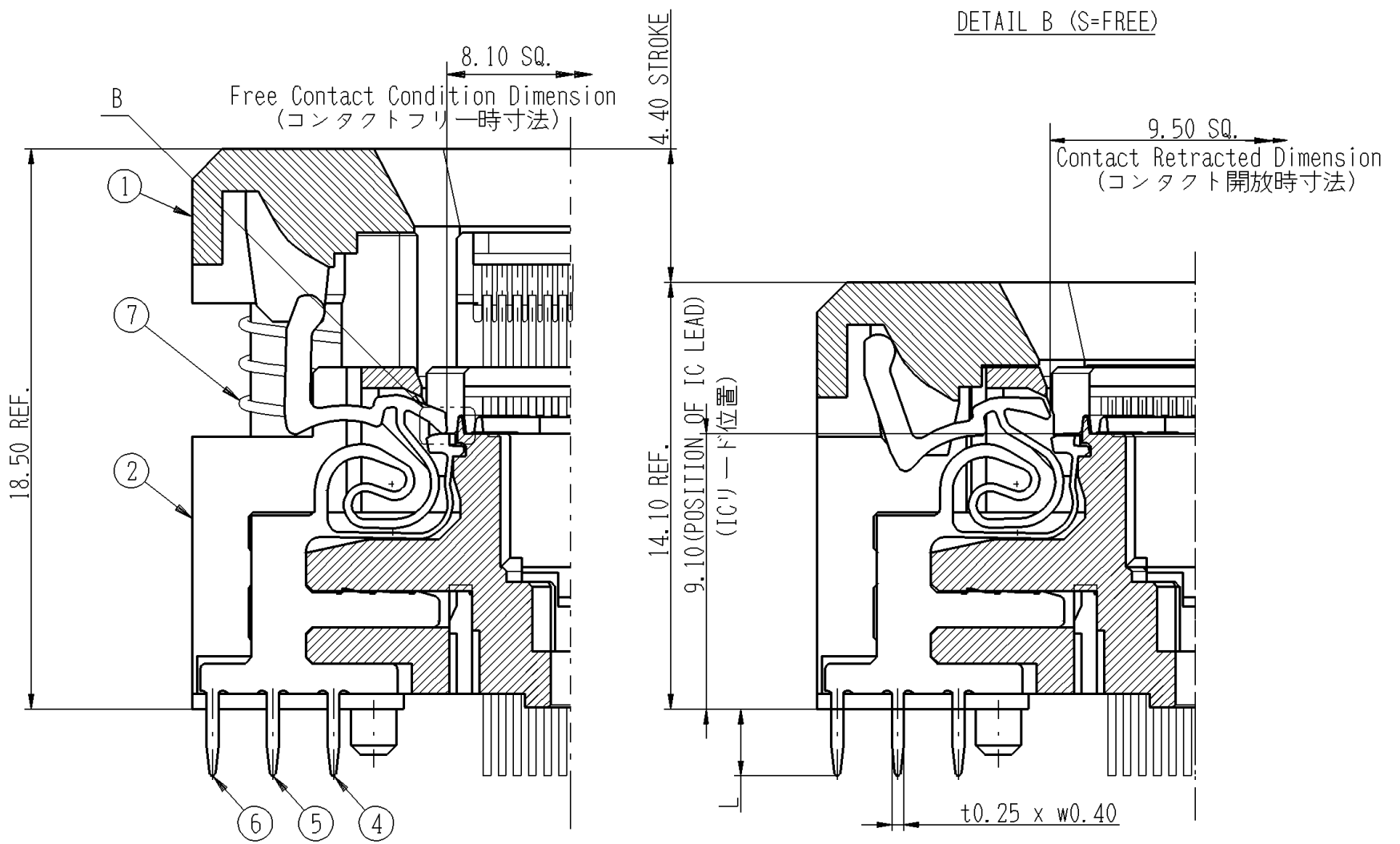
IC挿入方向  
Insertion ↓



CONTACT MOUNTING SCREW HOLE PATTERN  
(Pattern Shown Looking Down Through Top of Socket)  
プリント板穴あけ寸法図(表面より透視)

IC Package Outline (S=5/1)  
ICパッケージ参考図

Detail C (S=FREE)  
部品詳細図



Detail Of Operation (S=FREE)  
This Device Can Be Pressed On The Hatched Areas Shown In Drawing Above.  
ソケット操作部詳細 (S=FREE)  
ソケット操作時、カバーの印部を押して使用のこと。

製品名 TITLE	製品図番号 IDENT	仕様 SPEC	位置決めピン POSITIONING PIN	端子長さ L TERMINAL LENGTH
IC357-0484-142N-4	A115592-008	— — — — — — — —	WITHOUT	無
IC357-0484-142P-4	A115592-007	— — — — — — — —	WITH	有
IC357-0484-142N-3	A115592-006	— — — — — — — —	WITHOUT	無
IC357-0484-142P-3	A115592-005	— — — — — — — —	WITH	有
IC357-0484-142N-2	A115592-004	— — — — — — — —	WITHOUT	無
IC357-0484-142P-2	A115592-003	— — — — — — — —	WITH	有
IC357-0484-142N-1	A115592-002	— — — — — — — —	WITHOUT	無
IC357-0484-142P-1	A115592-001	— — — — — — — —	WITH	有
7	CS-704	4 4 4 4 4 4 4 4	SUS	—
6	CT4741-2-C-PD	— — — — — — 16 16	BeCu t0.25	Ni-Pd-Au PL.
	CT4741-1-C-PD	— — — — — — 16 16		Ni-Au PL. (CLASS BF)
	CT4741-2-C	— — — — — — 16 16		Ni-Pd-Au PL.
5	CT4741-2-B-PD	— — — — — — 16 16	BeCu t0.25	Ni-Pd-Au PL.
	CT4741-1-B-PD	— — — — — — 16 16		Ni-Au PL. (CLASS BF)
	CT4741-2-B	— — — — — — 16 16		Ni-Pd-Au PL.
4	CT4741-2-A-PD	— — — — — — 16 16	BeCu t0.25	Ni-Pd-Au PL.
	CT4741-1-A-PD	— — — — — — 16 16		Ni-Au PL. (CLASS BF)
	CT4741-2-A	— — — — — — 16 16		Ni-Pd-Au PL.
3	IC357-104 #ME	4 4 4 4 4 4 4 4	SUS	—
	IC357-0484-142N #IN-B	— 1 — 1 — 1 — 1	PES (GF)	BLACK
2	IC357-0484-142P #IN-B	1 — 1 — 1 — 1	PES (GF)	BLACK
	IC357-0484-142 #IN-A	1 1 1 1 1 1 1 1	PES (GF)	BLACK
部品番号 ITEM	部品名 DESCRIPTION	個数 QNT.	材質・寸度 MATERIAL	記事 CONTENT

- Note : 注記
- Socket should be held down to the P.W.B. by any other method to prevent it from floating during soldering.  
Mask holes on the P.W.B. to prevent solder migration.  
半田付けの際にはソケットベースがP.W.B.より浮き上がらない様にして下さい。  
又、半田上がりが発生しない様、マスキング等の処理をして下さい。
  - Keep the board trace out of the socket stand off area to avoid trace cut and socket tilting.  
ソケットスタンドオフエリア内の配線は避けて下さい。  
断線、及びソケットの浮き等、問題発生可能性があります。
  - Cool down the assembled P.C.board to room temperature before the washing process.  
洗浄工程に投入は、プリント板及びソケットが常温になってから実施のこと。
  - Marking shall be done.  
図に示す様に表示する。

- Specifications : 性能
- Insulation resistance : 1,000M ohm or more at 100VDC.  
絶縁抵抗 : DC100Vで測定し1,000M ohm 以上のこと。
  - Dielectric withstanding voltage : 100VAC for one minute.  
耐電圧 : AC100Vを1分間印加して異常の無いこと。
  - Contact resistance : 30m ohm or less at 20mV. (initial)  
接触抵抗 : 開放端電圧20mV以下で測定し初期状態にて30m ohm以下のこと。
  - Operation temperature : -40deg.C - +150deg.C  
使用温度 : -40deg.C - +150deg.C
  - Contact force : signal pin 0.392N(40gf) per pin.  
接触力 : signal pin 0.392N(40gf) per pin.
  - Operation force : 11.8N ±4.90N (1.20kgf ±0.50kgf)  
操作力 : 11.8N ±4.90N (1.20kgf ±0.50kgf)
  - Life span : 10,000 times (mechanical)  
寿命 : 機械的に10,000回

Please consult factory to verify latest revision N140331

指定外寸法公差 Tolerances ±0.3  
Unless otherwise specified

山一電機株式会社  
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

分類 (CLASS) QFP-pitch0.50-48Pin  
名称 (TITLE) IC357-0484-142\*-\*

図番 (DRW. NO.) A115592-001 / Sheet No. / REV. A

承認 APP.	承認 APP.	検図 CHK.	製図 DRW.	設計 DSGN.
Y. Kato	J. Miyaaki	Y. Wakabayashi	Y. Wakabayashi	

14-03-19 14-03-18 14-03-18 14-02-10